

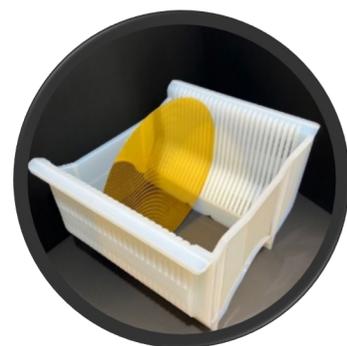
FULL AUTO PLATING SYSTEM for UBM

全自動無電解めっきシステム

: MODEL ELPT-UBM08-12



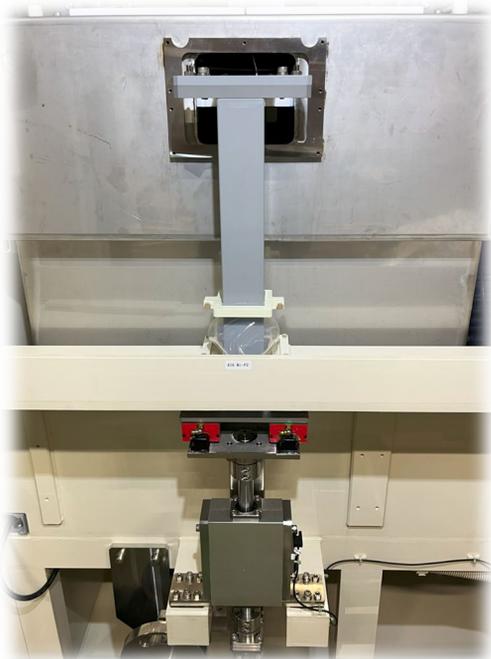
- Waferサイズ 6、8、12インチ 対応
- 各種プロセスに対応(Ni-P/Pd/Au、Ni-P/Au)
- 噴流・攪拌による優良なウエハー膜厚分布
- 素材:Si、SiC、GaO、GaNなどのパワー半導体
- 25枚フルキャリア 2列搬送対応 月産1万枚以上
- クリーンルーム/クラス1000対応



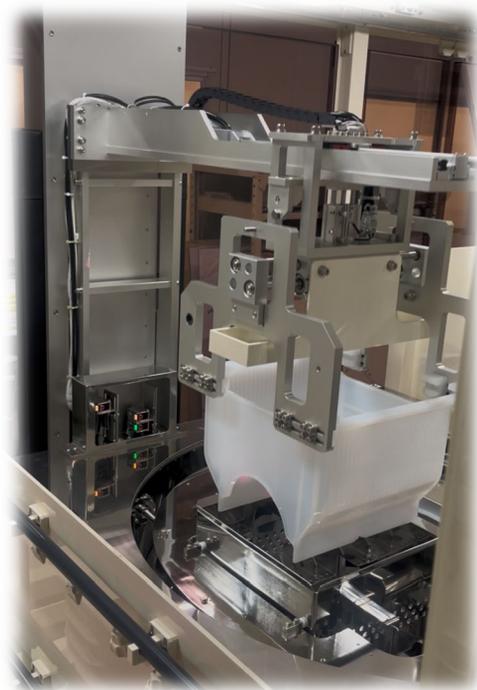
- 12インチ25枚/フルキャリア対応
- 薬液投入、洗浄機能 全自動対応
- 各薬液槽、高精度温度制御 $95^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$
- PP槽、テフロンコート槽、SUS鏡面槽-自動開閉蓋搭載



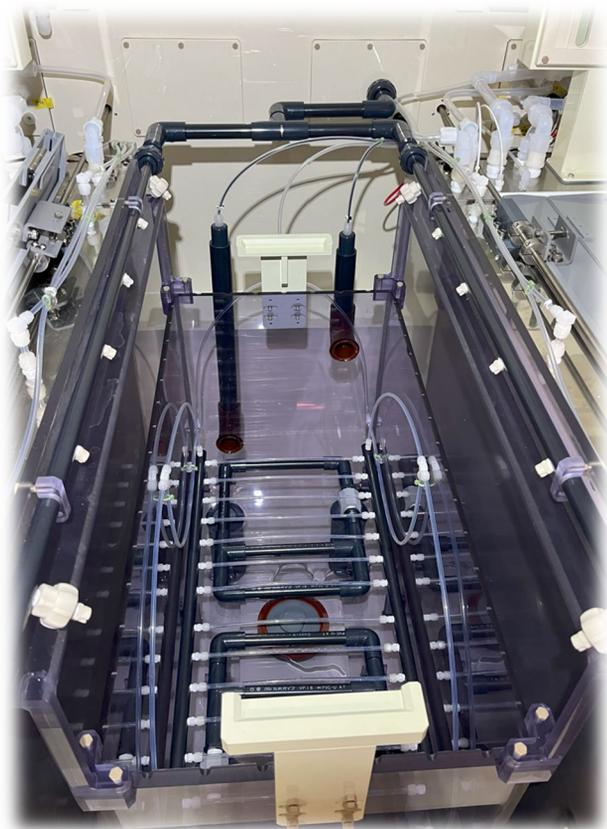
- 揺動機構 上下50mm 横50mmストローク対応
- ショック揺動対応可



- インラインスピンドライヤー
8-12インチ自動投入※バルンサーの段取り替えは必要です



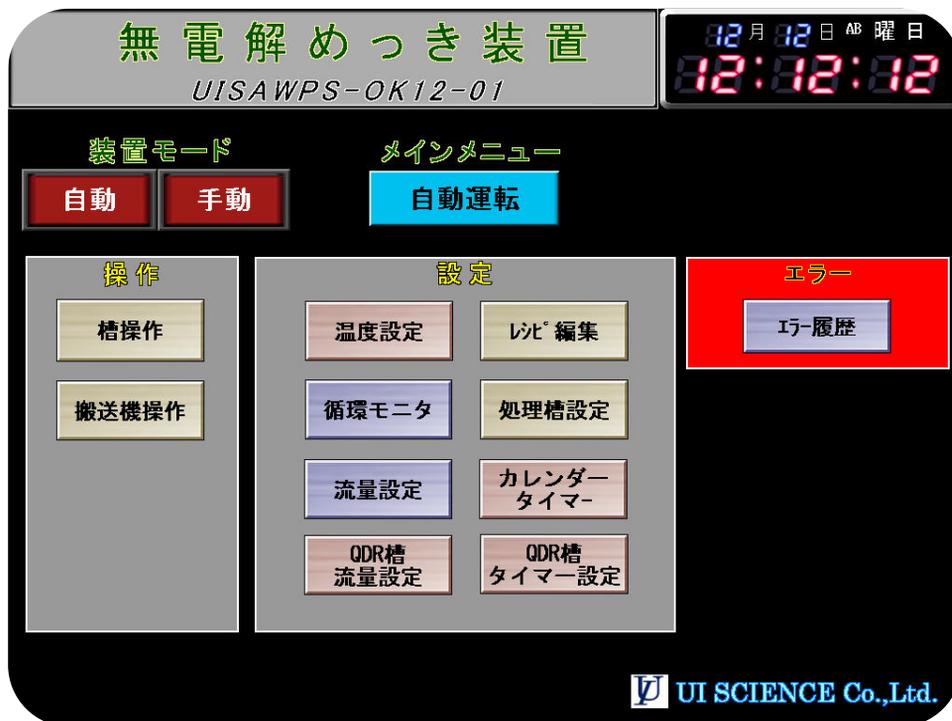
- QDR クイック排水+N2バブリング+シャワー機構



- 走行ロボット重量タイプ搭載、位置決め精度±1mm以下



- 生産監視自動録画システム搭載
- 生産管理システム搭載
- 生産レシピ登録、読出対応可



お問い合わせ
友藍サイエンス株式会社
s_umemoto@ui-science.co.jp